

BZ17-041**半導体製造用ウェット装置の組立・配線・配管の受託パートナー募集**提案提出期限

- 2017年8月31日

依頼企業の概要

- 株式会社エイ・エス・エイ・ピー
- URL : <http://www.asap-semi.co.jp>
- 主な事業内容：半導体製造装置（前工程）の設計製造販売
- 年間売上 5～6億円

提案者にとっての機会（協業形態）

	部材供給
	受託加工
	技術ライセンス
	受託開発
○	その他（ 受託生産 ）

求める技術とその背景

- 半導体製造用ウェット装置の組立・配線・配管を受託パートナーとなりうる組織を求めています。
- 設計図は弊社より提供いたします。
- 部品調達：加工部品は製造委託者側にて調達、購入品は当社より支給予定です。
- ウェット装置の仕様・製造条件など
 - 製造時に必要となる技術：腐食性薬液使用、ステンレス配管・PFA樹脂配管の設置技能が求められます。
 - ◇ 場合によっては、当社エンジニアが委託企業先で作業する、作業を教える、またはその部分の作業を当社にて請け負うことも可能です。
 - クリーンルームである必要はありませんが、外気が入り込まない製造・作業環境が必要になります
 - 製造費用：部品調達含め1000～1500万円/台程度を想定
 - 年間製造数：10台程度を目安

想定している用途

- 半導体前工程製造

想定されるビジネス規模

- 社内生産と並行して進めるため、年間10台程度の発注を想定

現時点で求める技術の完成度

- 現行で、半導体・食品・医薬品製造関連装置の組立実績があることが望ましい

対象とするアプローチ例（下記に限らない）

- 半導体製造装置メーカー、OEMメーカー

- 食品製造装置メーカー、OEM メーカー
- 医薬品製造装置メーカー、OEM メーカー

留意点

- 半導体製造装置に対する投資が進んでおり、受注量増加のため、新規に組立・配線・配管の受託可能なパートナーを求めています
- 設計は複数装置で共通化されています

BIZ SAITAMA の概要、提案方法はこちらの URL をご覧ください
http://biz-saitama.jp/exhibition_entry.html

【事務局】

- **BIZ SAITAMA** 実行委員会事務局：さいたま市産業創造財団
<http://www.sozo-saitama.or.jp/>
- 商談会に関するサポート：株式会社ナインシグマ・ジャパン
<http://www.ninesigma.co.jp/>

【問い合わせ窓口】

- メール：biz-sai9@sozo-saitama.or.jp
- 電話：03-3219-2006（ナインシグマ・ジャパン：BIZ SAITAMA 担当宛）